KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2019/172

af 16. november 2018

om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ([1]), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 2011/65/EU skal medlemsstaterne sørge for, at elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning, ikke indeholder visse farlige stoffer, der er opført i bilag II til nævnte direktiv. Dette krav gælder ikke de anvendelser, der er opført i bilag III til direktiv 2011/65/EU.

(2) De forskellige kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, som direktiv 2011/65/EU finder anvendelse på (kategori 1-11), er opført i det nævnte direktivs bilag I.

(3) Bly er et stof, der er underlagt begrænsninger, og som er opført i bilag II til direktiv 2011/65/EU. Anvendelsen af bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip var dog undtaget fra begrænsningen, og er i øjeblikket anført i undtagelse 15 i bilag III til det nævnte direktiv. Udløbsdatoen for den undtagelse var for kategori 1-7 og 10 den 21. juli 2016.

(4) Kommissionen modtog en ansøgning om en fornyelse af undtagelsen inden den 21. januar 2015 i henhold til artikel 5, stk. 5, i direktiv 2011/65/EU. Undtagelsen forbliver gyldig, indtil der vedtages en afgørelse om den pågældende anvendelse.

(5) Blyholdigt loddemateriale anvendes i flip chip-forbindelser, hvor loddematerialet forbinder chippen og bæresubstratet. Loddematerialet skal kunne modstå elektromigration ved de ekstremt høje strømtætheder, der kræves, og det skal være i stand til skabe en lagdelt lodning, som muliggør trinvis montage og ombearbejdning af komponenterne i løbet af fremstillingsprocessen. Det skal også have en stor strækevne for at mindske den termomekaniske belastning i de metallurgiske strukturer under loddematerialet, især i større chips.

(6) For visse anvendelser, der er omfattet af den nuværende undtagelse, er substitution eller eliminering af bly stadig ikke videnskabeligt og teknisk gennemførlig på grund af manglende pålidelige alternativer. Undtagelsen svækker ikke den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 ([2]). Den bør derfor fornyes for disse bestemte anvendelsesformål.

(7) For alle andre anvendelser, der er omfattet af undtagelsen, er betingelserne for fornyelse ikke opfyldt. Undtagelsen for disse anvendelser bør fortsat være gyldig i 12 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af nærværende delegerede direktiv i overensstemmelse med artikel 5, stk. 6, i direktiv 2011/65/EU.

(8) Eftersom der i øjeblikket ingen pålidelige alternativer findes for de anvendelser, der er omfattet af undtagelsen, bør undtagelsen for disse anvendelser fornyes for kategori 1-7 og 10 med den maksimale varighed på fem år indtil den 21. juli 2021. I lyset af resultaterne af de igangværende bestræbelser på at finde en pålidelig substitution forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovationen.

([1]) EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.
([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(9) For andre kategorier end 1-7 og 10 forbliver den hidtidige undtagelse gældende i de gyldighedsperioder, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2011/65/EU. Af hensyn til klarheden bør udløbsdatoerne tilføjes i det nævnte direktivs bilag III.

(10) Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 29. februar 2020 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen ordlyden af disse love og bestemmelser.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. marts 2020.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale love og bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2018.

På Kommissionens vegne
Jean-Claude JUNCKER
Formand

BILAG

Punkt 15 i bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes således:

»15.	Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip	Gælder for kategori 8, 9 og 11 og udløber den: — 21. juli 2021 for kategori 8 og 9 undtagen medicinsk udstyr til vitro-diagnostik og industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter — 21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik — 21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11.
15.a	Bly i loddemateriale til etablering af elektrisk forbindelse mellem halvlederskive og bæresubstrat i integrerede kredsløbspakker med flip chip, hvor mindst ét af følgende kriterier gør sig gældende: — der anvendes 90 nm-halvlederteknologi eller større — der anvendes en enkelt halvlederskive på 300 mm² eller derover sammen med hvilken som helst halvlederteknologi — stablede chippakker med en halvlederskive på 300 mm² eller derover eller silicium-interposere på 300 mm² eller derover	Gælder for kategori 1, 7 og 10 og udløber den 21. juli 2021.«